



22. 10. 2003

REC'D 31 OCT 2003	
WIPO	PCT

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 102 49 478.9

Anmeldetag: 24. Oktober 2002

Anmelder/Inhaber: Continental Teves AG & Co oHG,
Frankfurt am Main/DE

Bezeichnung: Anordnung eines Kraftsensors für
elektronische Bremssysteme

IPC: B 60 T 13/74

**Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.**

München, den 16. Oktober 2003
Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

Haust

**PRIORITY
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

BEST AVAILABLE COPY

22. Oktober 2002
GP/Du
P 10548

Dr. B. Bayer
E. Kelling
P. Linhoff
B. Piller
A. Schirling
B. Schmittner
J. Völkel

Anordnung eines Kraftsensors für Elektronische Bremssysteme

Bei elektromechanischen Bremssystemen ist es nötig, die Spannkraft zu messen. Dies geschieht idealerweise an einem, sich im Kraftfluss befindlichen, Teil. (29)

Der Topf, an dem sich das KGT abstützt, ist zwar ideal zur Kraftmessung, weil er sich im direkten Kraftfluss befindet, er ist aber zu unhandlich um auf ihn in einem industrialisierbaren Prozess Messelemente aufbringen zu können. 16-18

Als Abhilfe ^(Fig. 3-5) formt man den Topf so aus, das man ein oder mehrere „Fenster“ (1) durch einen Stanzvorgang am Umfang schafft. In diese(s) Fenster wird das extern gefertigte (und geprüfte) Sensorelement (Fig. 5) eingefügt. Den Zusammenbau zeigt Fig. 4.

Dieses Fügen kann durch Laserschweißen oder sonstiges erfolgen.

Auf Fig. 5 sieht man das Sensorelement (3), das Trägermaterial (2), die Schweißnaht (4) und die Bondpads (5) um den Sensor zu kontaktieren.

Diese Methode hat folgende Vorteile:

- (29)
1. Der Werkstoff für den Topf kann entsprechend den Steifig- und Festigkeitsanforderungen ausgewählt werden.
 2. Das Trägermaterial des Sensorelementes kann zum einen ideal an das Sensorelement angepasst werden, zum Anderen bedingt durch die geringe Größe auch in allen Fertigungsschritten, Temperaturprozessen kostengünstig verarbeitet werden.

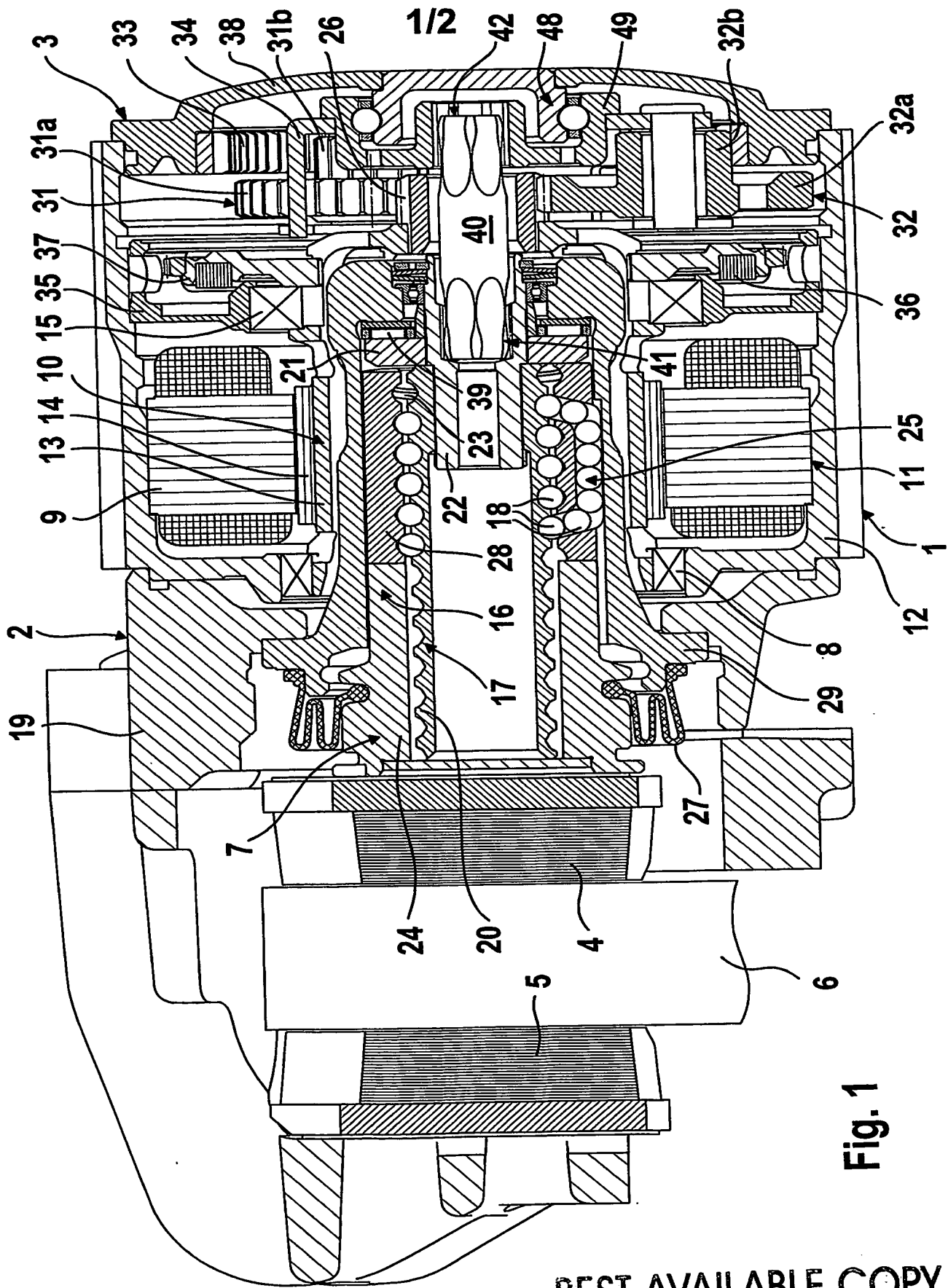


Fig. 1

BEST AVAILABLE COPY

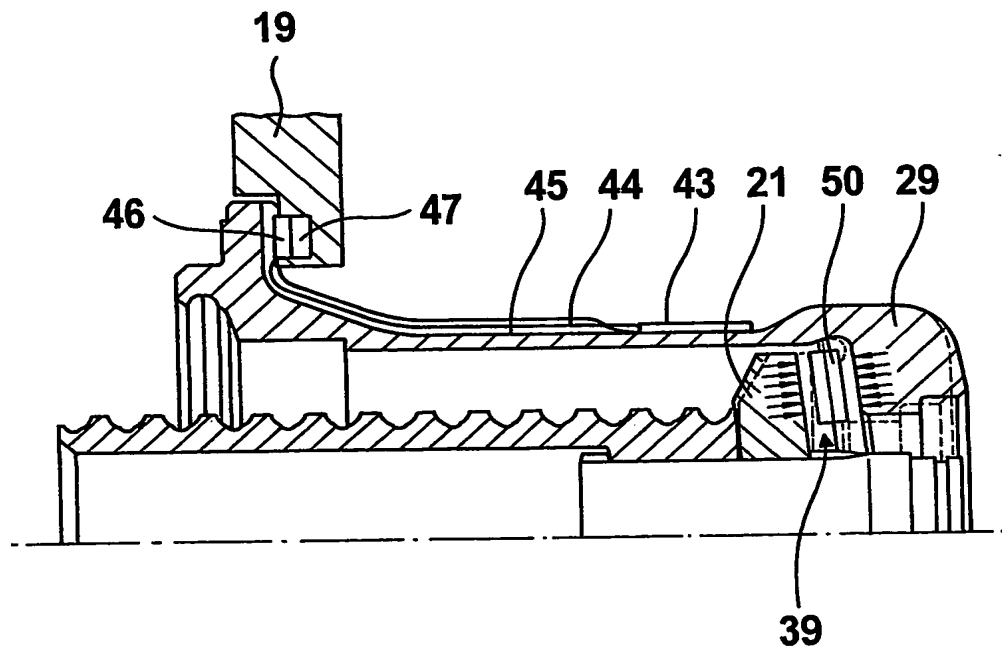


Fig. 2

